

RJ45MP R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Gniazda nadajnika RJ45 (magnetyczne) do gigabitowego Ethernetu (1000 base-T) z wbudowaną kompensacją, która aktywnie przeciwdziała sprzężeniom indukcyjnym i pojemnościowym oraz pozwala zaoszczędzić miejsce na płycie drukowanej.

Asortyment produktów obejmuje następujące konstrukcje:

- 90°, leżąca (pozioma) oraz 180°, stojąca (pionowa)
- górny zatrzask / dolny zatrzask
- Procesy lutowania THT, THR lub SMD
- Szeroki wybór różnorodnych konstrukcji, także z wbudowanymi kontrolkami LED oraz zaciskami ekranu
- Prędkość przesyłania danych maks. 1 Gb/s
- Pakowane na tacy (TY) lub na rolce (taśma na szpuli, RL)
- Kompatybilny ze złączem modułowym RJ45, zgodnie z ANSI / TIA-1096-A oraz IEC 60603
- Wytrzymałość dielektryczna ≥ 1500 V AC RMS (wartość szczytowa 2250 V AC) zgodnie z IEEE 802.3
- Wytrzymałość dielektryczna ≥ 1500 V AC (wartość szczytowa) lub ≥ 1500 V DC zgodnie z IEC 60603
- Zgodność z wymogami IEEE 802.3 (1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab lub 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)

Właściwości i zalety:

- Rozszerzony zakres temperaturowy od -40 °C do $+85$ °C dla maksymalnej wydajności
- Wzmocniona warstwa złota (30μ) dla lepszego zabezpieczenia przed korozją
- Odstęp minimum 0,3 mm zapewnia idealne rezultaty lutowania

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Złącze wtykowe do druku, Gniazda RJ45 transformatora, 100 MBit/s, POE, Połączenie lutowane THT/THR, 90°, Opcja zatrzaskiwania: dół, Liczba biegunów: 10, Tape
Nr zam.	2661710000
Typ	RJ45MP R1D 3.3E4N RL
GTIN (EAN)	4050118675177
Ilość	200 Szt.
opakowanie	Tape

RJ45MP R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 10,61 g

Właściwości elektryczne

Wytrzymałość napięciowa styk / ekran 1500 V DC Wytrzymałość napięciowa styk / styk 1000 V DC

Specyfikacje systemu

Klasa mocy	100 MBit/s, POE	Liczba biegunów	10
Opcja zatraskiwania	dół	Proces lutowania	Lutowanie rozpliwowe, Lutowanie ręczny, Lutowanie falowe
Raster w mm (P)	1,27 mm	Raster w calach(P)	0,05 inch
Rodzina produktów	OMNIMATE Data - gniazdo RJ45 transformatora	Stopień ochrony	IP20
Szybkość przesyłania danych	100 MBit/s, POE	kąt odejścia	90°
montaż na płytce drukowanej	Połączenie lutowane THT/ THR		

Opakowanie

opakowanie	Tape	Długość VPE	345 mm
Szerokość VPE	125 mm	Wysokość VPE	345 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Broszura/Katalog	Catalogues in PDF-format

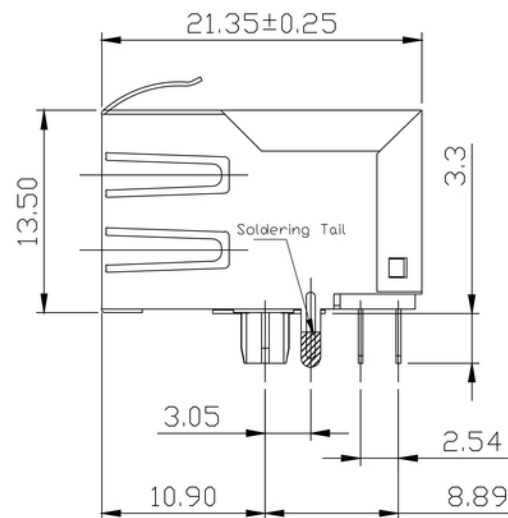
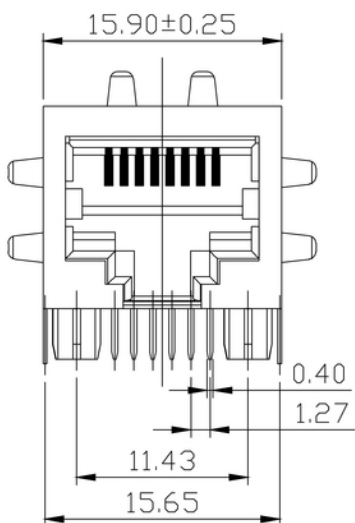
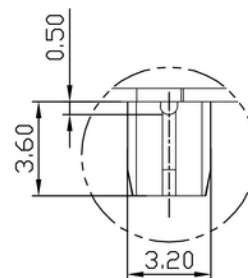
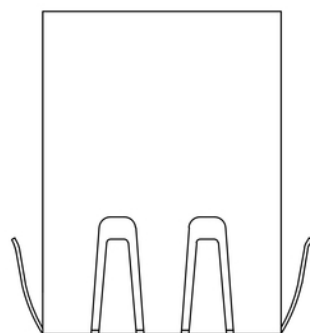
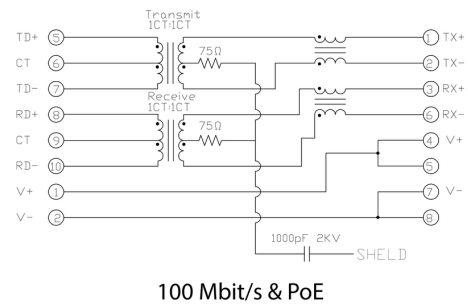
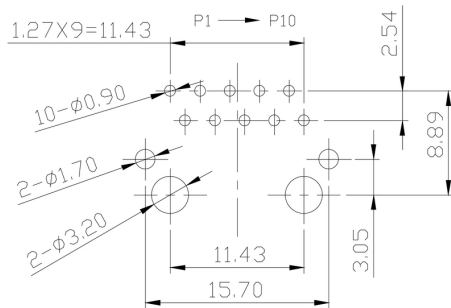
RJ45MP R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Układ płytek obwodu drukowanego



RJ45MP R1D 3.3E4N RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat

Characteristics

Inductance	350 µH min. @ 100 kHz, 100 mV, 8 mA DC Bias
Leakage Inductance	0.3 µH max. @ 100 kHz, 100 mV
Insertion Loss	1.1 dB max. @ (1 - 100) MHz
Return Loss	18 dB min. @ (1 - 30) MHz 16 dB min. @ (30 - 60) MHz 12 dB min. @ (60 - 80) MHz
Cross Talk	30 dB min. @ (1 - 100) MHz
Common Mode Rejection	30 dB min. @ (1 - 100) MHz

Code	Description	Options
RJ45	Category	G1, G6, G6A, C5e, M, G1, G10, U, MP, MP+
G1	Performance Category	C5, C6, C6A, C5e, M, G1, G10, U, MP, MP+
R	Assembly on PCB	R, S, T
1	Number of Ports	1, 12, 14; ... 21, 41; ...
U	Direction, latch style	U, D, V, Y
3.2	Solder Pin length	3.2, 1.6, D
E	EMI tabs (ground fingers)	E, N
4	Contact surface thickness	4, 1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"
GY/GY	LED	Y/G, G/Y, GY/GY, O/G, R/O, ... N
TY	Packaging	TY, RL

RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY

Kody typów

Data sporządzenia 15 kwietnia 2021 07:49:11 CEST

Aktualizacja katalogu 09.04.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.